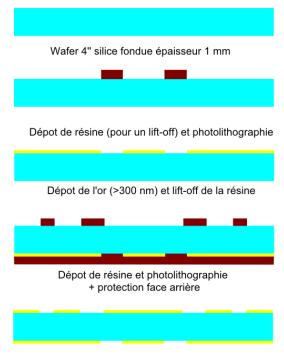
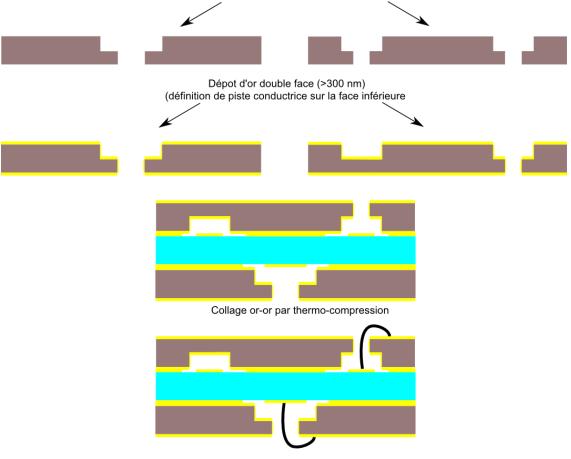
Process flow



Dépot de l'or et lift-off de la résine

Gravure DRIE 2 niveaux des substrats supérieur et inférieur en silicium (épaisseur 1mm)



Connection électrique par ball bonding